

2023年 8月 4日

委員各位殿

一般社団法人 溶接学会
マイクロ接合研究委員会
委員長 福本信次
(公印省略)

【対面 単独開催】

マイクロ接合研究委員会 開催通知

第143回マイクロ接合研究委員会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合せの上
ご出席下さいますようご案内申し上げます。

出欠は9月4日(月)までにお知らせ下さい

1. 日 時 2023年(令和5年) 9月 11日(月) 10:30～16:30
2. 場 所 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 912+913会議室
 東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 11 号 日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階
3. 幹事会のご案内
 幹事会を 12:00～開催いたしますので、幹事または代理の方はご出席下さいますよう
 お願い申し上げます。会場は 911 会議室です。

【出欠・事務関連の連絡先】

一般社団法人溶接学会 事務局 木暮
E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp TEL: 03-5825-4073

第143回マイクロ接合研究委員会
プログラム

日 時: 2023年 9月 11日(月) 10:30~16:30

場 所: 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913+912 会議室(東京 日本橋)

時 間	題 目	講 演 者
司 会 石垣幸一（タムラ製作所）		
10:30～11:15	『接合後に高融点化する Si 基フィラーの材料設計とセラミックス高耐熱接合への応用』 (資料番号MJ-840-2023)	京都市産業技術研究所 ○小濱和之
11:15～12:00	『高強度超短パルスレーザを用いた新規ナノ粒子材料合成』 (資料番号MJ-841-2023)	株式会社 illuminus ○中村貴宏, 黒田陸斗, 柴田秀平
12:00～13:00	昼 食 休 憩	
13:00～13:10	委 員 会 議 事	
司 会 宇野智裕（日本製鉄）		
13:10～13:55	『リチウムイオン電池の電極製造プロセスにおける半導体レーザ乾燥法』 (資料番号MJ-842-2023)	レーザーライン株式会社 ○皆川邦彦
13:55～14:40	『車両電動化に求められるレーザ溶接技術と固相接合技術について』 (資料番号MJ-843-2023)	株式会社 LINK-US, 千葉大学大学院 ○齋藤茂樹
14:40～15:00	休 憩	
司 会 松坂壮太（千葉大学）		
15:00～15:45	『化合物半導体(SiC)の結晶へき開型切断加工』 (資料番号MJ-844-2023)	三星ダイヤモンド工業株式会社 ○北市充, 浅井義之, 福西利夫
15:45～16:30	『半導体結晶材料のレーザ加工／スライシング技術』 (資料番号MJ-845-2023)	東京工業大学 ○徳永大二郎 千葉大学 比田井洋史

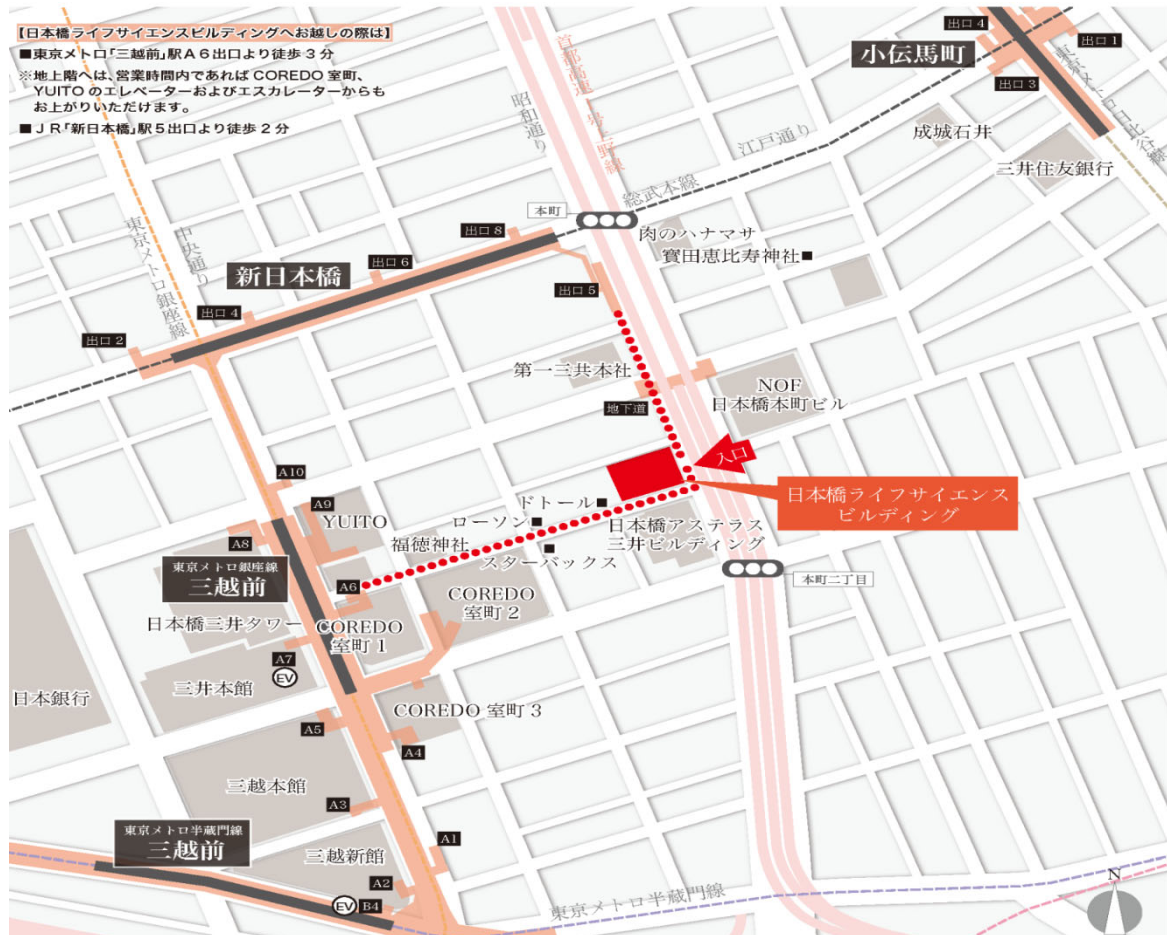
※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

4.配付資料について

当日の配布資料は委員会開催前にダウンロードシステムを利用し皆様へご送付致します。
開催当日までにご自身にて印刷を行っていただきご準備のうえご参加をお願いいたします。

✓配付資料は各自でご持参ください。会場に紙資料のご用意はございません。

(案内図)



アクセス

- ・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6出口より徒歩3分
- ・J R総武本線「新日本橋」駅 5番出口より徒歩2分
- ・J R各線「神田」駅 南口より徒歩 11 分
- ・J R各線「東京」駅 新日本橋口より徒歩 17 分